

## < 参加者募集 >

日米半導体プログラム UPWARDS に基づく  
米国 Boise State University 滞在 (2026 年 3 月)

春休みに米国アイダホ州にある Boise State University (BSU : <https://www.boisestate.edu/>)に 約 10 日間滞在し、自身の研究内容を議論しながら半導体について学ぶプログラムを実施します。参加を希望する方は、応募フォームから応募してください。滞在中の学費と経費は九大の旅費規程に則り、UPWARDS の寄附金で賄われる予定です。

Micron 財団および東京エレクトロンご支援の下、半導体人材育成を目的とした日米 UPWARDS (※) のプログラムを行っています。このプログラムには、日本の 5 大学 (東北大、東京科学大、名古屋大、広島大、九州大) と米国 6 大学 (University of Washington、Purdue University、Rochester Institute Technology、Rensselaer Polytechnic Institute、Virginia Tech、Boise State University) が参画しています。

### 記

- ・日 程 : 2026 年 3 月 4 日 (水) ~ 3 月 15 日 (日) (数日前後する可能性があります)
- ・場 所 : Boise State University (BSU) @ Boise, ID, US
- ・内 容 : 半導体セミナー、研究発表とディスカッション。Micron 本社見学。
- ・対 象 者 : 電気情報工学科 4 年 ~ 博士課程学生で、2026 年 4 月以降も九大に在籍する者。  
パスポートを持っている者、または申請中の者。  
米国渡航に VISA が必要な国籍の者は VISA 取得済みの者。  
女子の参加を強く推奨します。
- ・人 数 : 5 名 ~ 10 名 (応募者が多い場合は、志望動機・面接等で選抜)
- ・滞 在 : 徒歩圏ホテルを予定  
(昨年度は Holiday Inn Express Boise - University Area, an IHG Hotel)
- ・参 加 費 : 航空券とホテル代は九大から一括支払い予定。(立替不要)  
ESTA、海外旅行保険は自己負担。  
その他滞在費は九大の旅費規程に則り、規定額を後日精算予定。(UPWARDS 寄附金)
- ・募集期限 : 2025 年 12 月 19 日 (金)
- ・応募 URL : <https://forms.gle/YrCTKdQmbcjzP25N9>
- ・問合先 : システム情報科学研究所 湯浅 (hiromi.yuasa@ed.kyushu-u.ac.jp)  
UPWARDS 事務局 (upwards@mag.ed.kyushu-u.ac.jp)

